

Sonic Fast Recovery Diode

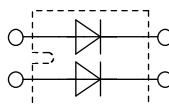
High Performance Fast Recovery Diode

Low Loss and Soft Recovery

Parallel legs

Part number

DHG 100 X 1200 NA



Backside: Isolated

E72873

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package:

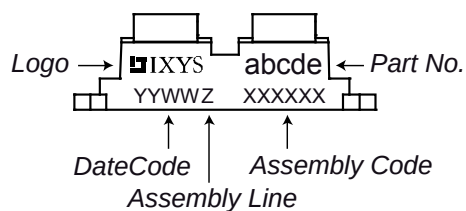
- Housing: SOT-227B (minibloc)
- Industry standard outline
- Cu base plate internal DCB isolated
- Isolation Voltage 3000 V
- Epoxy meets UL 94V-0
- RoHS compliant

Ratings

Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1200	V
I_R	reverse current	$V_R = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			100	μA
		$V_R = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1.2	mA
V_F	forward voltage	$I_F = 50\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			2.16	V
		$I_F = 100\text{ A}$				2.78	V
		$I_F = 50\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			2.13	V
		$I_F = 100\text{ A}$				2.97	V
I_{FAV}	average forward current	rectangular $d = 0.5$	$T_C = 65^{\circ}\text{C}$			50	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		1.26	V
r_F	slope resistance					15.3	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.60	K/W
T_{VJ}	virtual junction temperature			-40		150	$^{\circ}\text{C}$
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			200	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			500	A
I_{RM}	max. reverse recovery current		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		45		A
		$I_F = 60\text{ A}; V_R = 600\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		60		A
t_{rr}	reverse recovery time	$-di_F/dt = 1200\text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		200		ns
			$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		350		ns
C_J	junction capacitance	$V_R = 600\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		27		pF

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.10		K/W
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				30		g
M_D	mounting torque		1.1		1.5	Nm
M_T	terminal torque		1.1		1.5	Nm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3000			V
		t = 1 minute	2500			V
$d_{Spp/App}$	creepage striking distance on surface through air	terminal to terminal	10.5	3.2		mm
$d_{Spb/Apb}$	creepage striking distance on surface through air	terminal to backside	8.6	6.8		mm

Product Marking

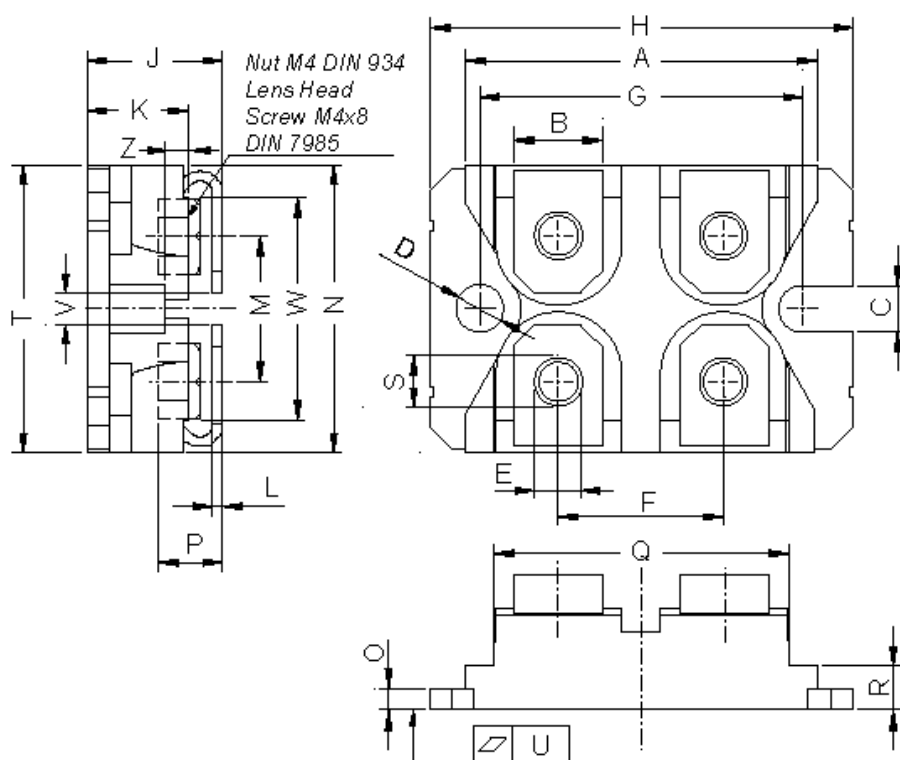


Part number

D = Diode
 H = Sonic Fast Recovery Diode
 G = extreme fast
 100 = Current Rating [A]
 X = Parallel legs
 1200 = Reverse Voltage [V]
 NA = SOT-227B (minibloc)

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Code Key
Standard	DHG 100 X 1200 NA	DHG100X1200NA	Tube	10	507759

Outlines SOT-227B (minibloc)



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106

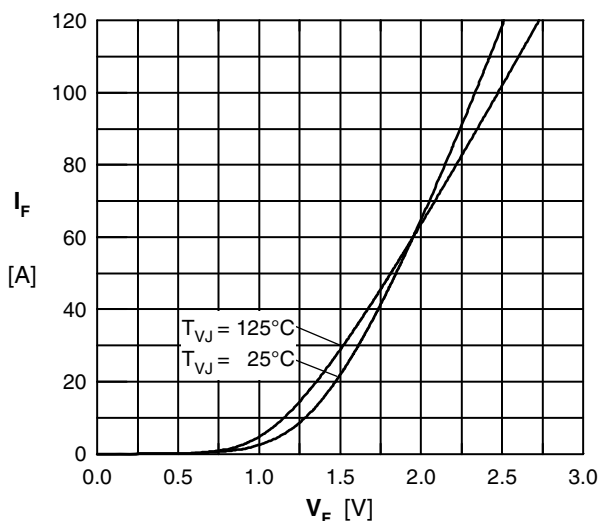


Fig. 1 Typ. Forward current versus V_F

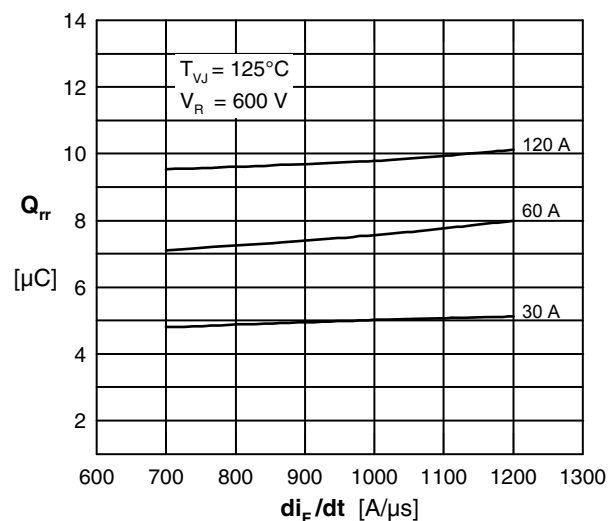


Fig. 2 Typ. reverse recov.charge Q_{rr} vs. di/dt

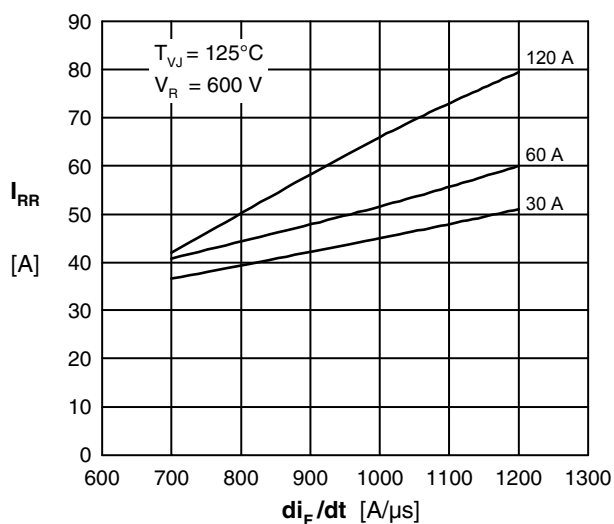


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} vs. di/dt

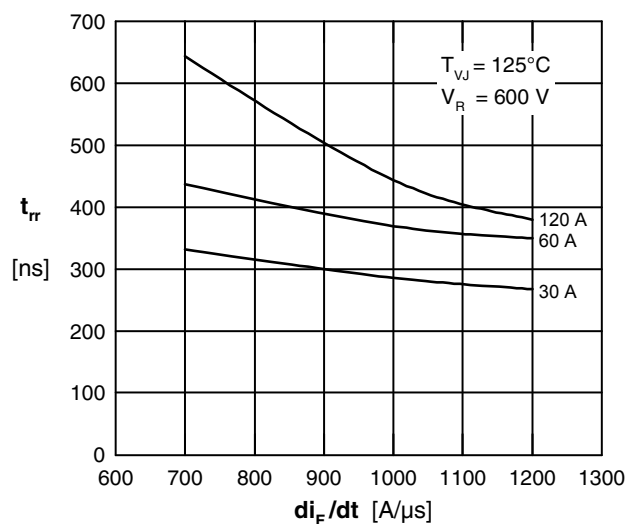


Fig. 4 Typ. recovery time t_{rr} versus di/dt

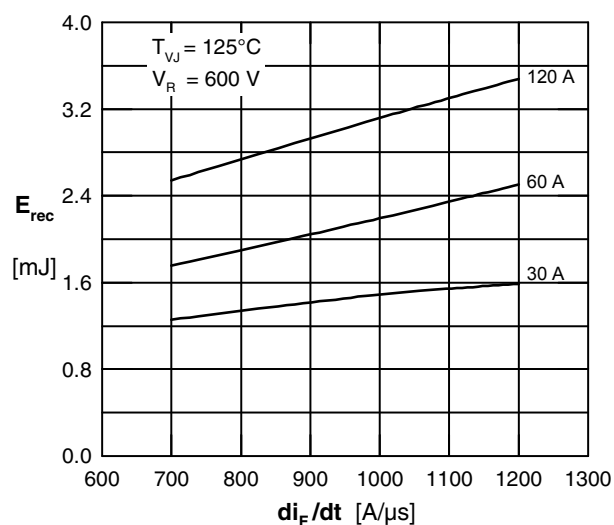


Fig. 5 Typ. recovery energy E_{rec} versus di/dt

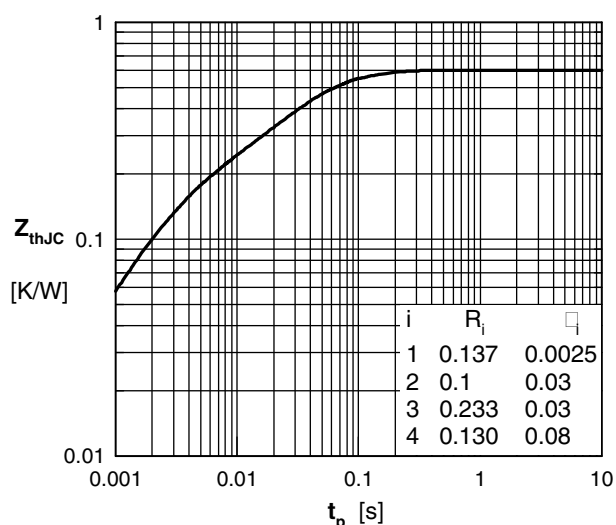


Fig. 6 Typ. transient thermal impedance

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9